國內可供投資進駐土地訊息彙總表

2025-12

基本資料			辦理情形	聯絡窗口	園區規劃			備註
縣市	名稱	開發單位			區位	總面積/產業用地面積	可進駐產業類別	
台北市	北投士林科技園區	臺北市政府產業發展局	市有地占科專區面積4成(9.76公頃)，其中T16、T17、T18占8.38公頃，採設定地上權方式招商，三塊基地皆於110年決標，其中T16基地由金仁寶集團旗下之仁寶電腦工業股份有限公司與康舒科技股份有限公司以合作聯盟共同得標，於111年1月18日由專案公司-金仁寶總部資產開發股份有限公司與北市府簽訂契約，並於112年2月8號開工，將基地規劃作為總部智慧創新園區，預計116年營運啟用；另T17、T18基地由新光人壽保險股份有限公司得標，於111年11月12日與本府簽訂契約，未來將釋出上萬坪辦公空間。市有地T3、T4、T12則刻由本府地政局土地開發總隊規劃，T12刻正規劃辦理設定地上權招商。	臺北市政府產業發展局	臺北市北投區軟橋段88、91、93地號。 北投士林科技園區位於士林與北投交界處，周邊公路、捷運路網便捷，交通聯外便利；園區鄰近北投、天母等優質生活圈，且各式藝文活動空間及教育設施圍繞，商業活動熱絡，生活機能完善。 周邊產學研資源豐富，除了榮總、振興醫院、新光醫院、和信醫院、陽明交通大學、臺北護理健康大學與衛福部國家中醫藥研究所等，更有東吳大學、銘傳大學等多所高等教育學府，擁有豐沛頂尖學研資源與人才供給之優勢；附近更有華碩、和碩、英業達等資通訊大廠深耕，搭配本市既有資通訊產業深厚基礎與能量，深具引進生技、數位醫療、智慧科技與支援技術等本市優勢產業及相關新興產業之潛力。 因應產業跨域發展及全球高齡化、少子化趨勢，世界各國皆積極推動「智慧健康醫療」，應用資通訊技術於健康及醫療照護領域，以促進與加強健康領域的發展，並增進醫療的可近性、效益與降低醫療成本。市府善用北投士林科技園區周邊醫療資源豐沛及區位優勢，園區以智慧跨域為定位，「智慧健康產業」與「數位技術服務」產業為主軸，積極引入資通訊、生技、新興科技等相關產業，進一步延伸內科、南軟之臺北科技廊帶能量。	83,816平方公尺 / 科技產業專用區	智慧健康醫療、數位技術服務	

高雄市	仁武產業園區	高雄市政府	108 年 10 月底完成報編、 109年正式進入開發階段，第一期統包工程於 109 年 11 月 19 日辦理動土典禮。	高雄市政府經濟發展局	基地坐落於仁武區，鄰近國道10號與仁武交流道，可快速連接國道1號、國道3號，市區道路緊鄰水管路、仁林路及鳳仁路，亦可就近連接市區及鳳山、岡山等產業聚落。	74公頃& 48公頃	園區未來將鎖定航太及高階製造產業，計畫引進電子及光學製品、運輸工具、金屬製品、電子零組件、機械設備等製造業。	
新北市	新北國際AI+智慧園區招商案公開標租案(第2次公告)	新北市政府	公告期間: 114年12月3日至115年3月2日下午17時止。	新北市政府經濟發展局招商科	林口區新頭湖段54、61、68、69及75地號等土地。	第1區面積為12,541.07平方公尺、第2區面積為9,347.60平方公尺、第3區面積為8,509.04平方公尺(皆為第三之二種產業專用區)。	光學精密儀器產業、電子通訊產業、電子零組件製造業及機械設備製造業(需符合經濟部低污染認定基準)。	
	林口區力行段第四種產業專用區土地招商案	新北市政府經濟發展局	刻正彙整產業需求及制定招商策略，調整招商文件，預計114年第3季辦理公告招商作業。	新北市政府經濟發展局	新北市林口區力行段1297、1298、1299、1297-1、1298-1、1299-2等6筆地號土地。	(一)面積：13,434.12平方公尺。 (第四種產業專用區)	AI相關研發製造產業(以公告之投標須知內容為主)。	招商資訊與招商文件請至下列網址瀏覽：
桃園市	八德興豐科技園區	桃園市政府	預計開發完成期程為116年底	桃園市政府經濟發展局開發管理科	範圍南側鄰接宥辰八德工業區，東以興豐路2350巷為界，北以興豐路為界，西以國道二號為界	9.85公頃	規劃引進塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業、其他製造業等產業	
	大園內海產業園區	桃園市政府	預計開發完成期程為116年底	桃園市政府經濟發展局開發管理科	本市大園區內海埤段313筆土地	29.74公頃	規劃引進金屬製品製造、電力設備及配備、電腦、電子零組件、機械設備製造業等產業。	
	平鎮東龍科技園區	桃園市政府	預計開發完成期程為116年底	桃園市政府經濟發展局開發管理科	平鎮區東勢里、龍潭區九龍里(平鎮東金段及龍潭區雙連段14筆土地)	6.204公頃(產業用地:3.72公頃)	規劃引進食品及飼品製造業、電子零組件、機械設備、運輸及倉儲等產業	
	新屋頭洲科技園區	桃園市政府	預計開發完成期程為118年底	桃園市政府經濟發展局開發管理科	中壢(過嶺地區)楊梅(高榮地區)新屋(頭洲地區)觀音(富源地區)都市計畫區西南側，東以梅高路，北以高鐵南路為規劃範圍	26.22公頃(產業用地15.83公頃)	規劃引進電子零組件製造業、機械設備製造業、倉儲業等產業	
	大溪科技園區	桃園市政府	預計開發完成期程為118年底	桃園市政府經濟發展局開發管理科	大溪(埔頂地區)都市計畫區西南側、大溪都市計畫區西側；南側臨台3線，可接快速道路台66線及國道3號大溪交流道	29.32公頃(產業用地:17.64公頃)	規劃引進食品製造業、金屬製品業、機械設備、電子電腦產品及其他低汙染高科技等產業	
	大園智慧科技園區	桃園市政府	預計開發完成期程為118年底	桃園市政府經濟發展局開發管理科	本市大園區港口段339筆土地及艋舺段11筆土地	44.73公頃(產業用地:26.92公頃)	規劃引進紡織、化材、電子零組件、機械設備、金屬製品製造及技術研發等產業	

彰化縣	打鐵厝產業園區	彰化縣政府	本案刻正辦理開發計畫暨細部計畫書及可行性規劃報告書審查作業，完成後核定產業園區設置並向經濟部產業發展署申請備查。	彰化縣政府經綠處產發科	申請基地位於彰化縣鹿港鎮，基地座標(經差二度分帶座標系統TWD97)約介於N2661600-N2662000及 E194400-E195100。 本園區所在之打鐵厝位居彰北中心，南側有彰18 線（鹿東路）及縣道142 線（彰鹿路），東距彰化市及國道一號彰化交流道約 6 公里；西距鹿港鎮約3.5 公里、台 61 線鹿港交流道約 5 公里、彰濱工業區約 6 公里。	總面積約10公頃，產業用地面積約6公頃	機械設備製造業、汽機車及自行車零件製造業、醫療器材及用品製造業、批發業、餐飲及連鎖便利商店等支援性產業	
	二林精密機械產業園區	彰化縣政府	1.二林精密機械園區可租售產業用地面積約212.25公頃，截至目前已有380廠商表達進駐意願，需地面積達616.77公頃，因需求大於供給，未來租售傾向以抽籤方式辦理。 2.預計111年底前完成二階環評審查作業，並於112年完成土地取得，第一期開發區之開發期程為113年到114年，114年後可開始營運。	彰化縣政府產業發展推動辦公室	位於彰化縣二林鎮與芳苑鄉交界處台糖萬興農場內，緊鄰中科二林園區，往東約5公里可達溪湖，往西南約6公里可抵二林。	總面積353公頃，產業用地面積212公頃	精密機械元件業、關鍵機械組件業、工具機業及關鍵機電系統業等鏈結效益顯著之創新機械業	
南投縣	草屯工藝產業園區	南投縣政府	1.109年11月24日核定設置公告。 2.111年8月假設工程開工。 3.111年12月起進行第1次及第2次土地公告標售，截至112年7月申購率達約55%，並預定於112年8月辦理第3次公告。 4.園區整體開發工程預計於115年完工。	南投縣政府建設處產業發展科	位於草屯鎮新富仁段1078-7等地號土地，位於南投縣草屯鎮中正路(省道台14線)草屯植物公園南側，主要以中正路為對外聯外道路，距離台3甲僅約0.7公里，距離國道3號草屯交流道僅約5公里。	總面積＆產業:總面積13.9423公頃，產(一)面積8.7935公頃。	木竹製品製造業(C14) 金屬製品製造業(C25)，其中金屬鍛造業(C2541)、粉末冶金業(C2542)、金屬熱處理業(C2543)、金屬表面處理業(C2544)及其他金屬加工處理業(C2549)為不可引進行業 其他製造業(C33) 食品製造業(C08)，其中屠宰業(C0811)為不可引進行業 批發業(G45-46) 專門設計業(M74)	
屏東縣	屏東熱帶農業特色產業園區	屏東縣政府	招商中	屏東縣政府農業處農業企劃科	本案基地座落於屏東縣長治鄉德和路、黃金路及德華路所圍之街廓，緊鄰國道3號及台27線，可快速連結南部重要城市、小港機場、高雄港。	總面積29.01公頃/產業用地14.19公頃	進駐產業以食品與飼品製造業、飲料製造業、木竹製品製造業為主，也開放廠商申請設立觀光工廠。	https://www.ptas.tw/

	屏東縣六塊厝產業園區	屏東縣政府	招商中	屏東縣政府城鄉發展處工商科	本基地位於屏東縣屏東市西南側，為台糖公司所有之六塊厝農場。基地東側緊鄰六塊厝排水堤防道路；北側緊鄰屏東加工出口區；西側則緊鄰屏東縣六塊厝水資源處理中心；南側則與零星工廠、住家及農田為鄰；「189」縣道由北向南貫穿，將基地分為東、西兩個部份，往北可銜接省道「台 1」線後，往東可進入屏東市區，往西經高屏大橋可進入高雄市。「189」縣道往南約 6 公里可連接東西向快速公路高雄潮州線(省道「台 88」線)後，往東可銜接「國道 3 號」，往西連接「國道 1 號」，交通條件甚為便捷。	總面積19.67公頃/產業用地12.39公頃	本園區係朝向「具區域特色之綜合性產業園區」為發展主軸，預計引進之產業主要為汽、機車零件製造業、電子零組件製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業、照明設備及配備製造業、食品製造業、化妝品製造業等。	
宜蘭縣	宜蘭一結工業區	宜蘭縣政府	請逕洽本府工商旅遊處工商科閱覽宜蘭一結工業區可行性規劃報告書。	宜蘭縣政府工商旅遊處工商科			請逕洽本府工商旅遊處工商科閱覽宜蘭一結工業區可行性規劃報告書。	
花蓮縣	花蓮縣公告出租花蓮縣光華樂活創意園區後期產業用地(一)土地，並自公告日起受理申請。		公告期間：自民國111年4月6日至111年5月15日止。 屬<產業創新條例>規範工業區內之「產業用地(一)」，依土地使用分區之規定，以供生產、設計、研究發展、環境檢測、產品檢驗、儲配運輸物流及倉儲事業使用為主，同時須為經花蓮縣政府審查同意之低汙染性事業。 相關資訊及檔案下載，請參花蓮縣政府官網	花蓮縣政府觀光處工業管理科	花蓮縣吉安鄉光華段二小段151地號等40筆土地			

台東縣	鹿野都市計畫工業區	台東縣政府	閒置中之樹林地	財政及經濟發展處 - 財產管理及開發科	鹿野鄉中華段372地號(鸞山連絡道路與中華路一段交叉口處、鹿野國小操場旁)	4,439.56平方公尺（全區為乙種工業區）	電子零組件加工製造業、汽機車零組件製造業、機械設備製造業、食品製造業、運輸業、倉儲業等(排除高污染產業)	
金門縣	金門縣產遊博覽園區產業專用區（一）出租		公告期間：自民國111年4月11日至111年6月10日止，為期60日。 園區產業專用區（一）出租條件、程序、標示、價格、用途、使用限制、容許引進之產業類別及其他相關事項，分別詳載於園區產業專用區（一）出租手冊內容。 出租手冊可至該府建設處網站（https://ead.kinmen.gov.tw/）/產博園區專區下載。		本園區位於金門縣環境保護局及尚義環保公園對面	面積共約 119,227.86㎡（約 11.92 公頃）		